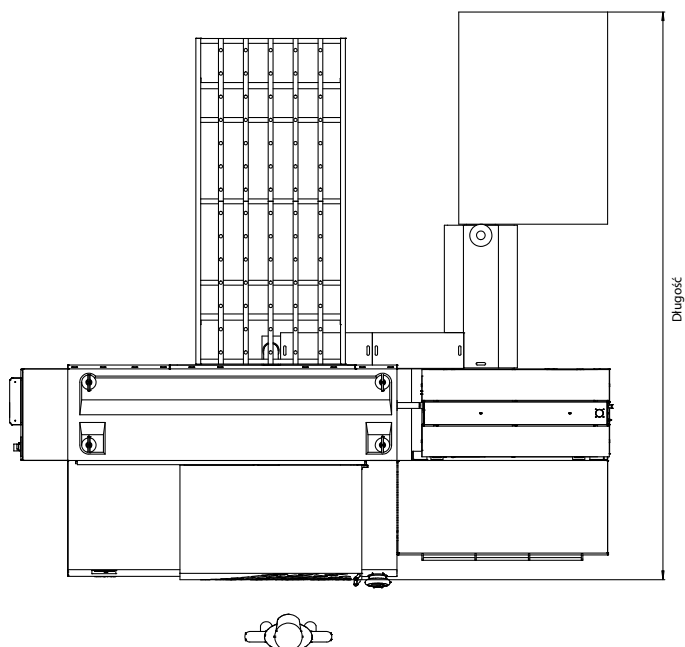
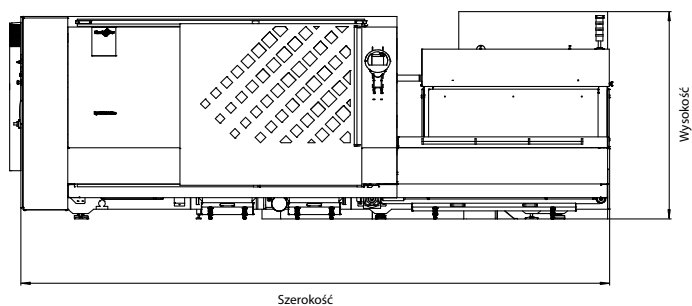


Dane techniczne ByVention 3015

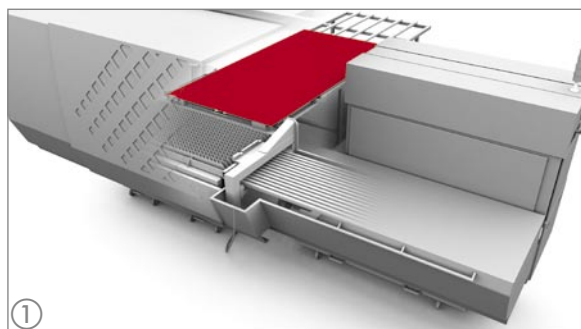


ByVention 3015

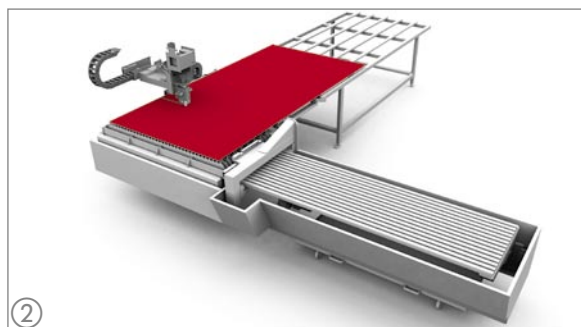
Moc lasera	2200 W	4400 W
Długość	6000 mm	6000 mm
Szerokość	6000 mm	6400 mm
Wysokość	2150 mm	2150 mm

Innowacyjna koncepcja przepływu materiału

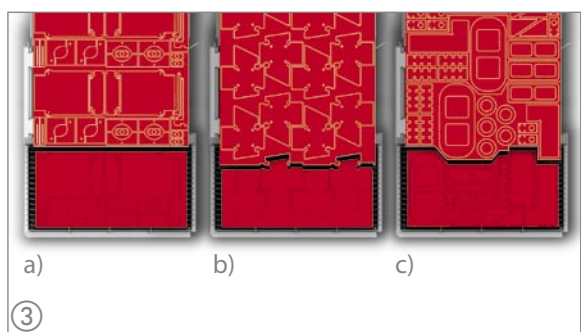
ByVention jest najmniejszym urządzeniem do laserowego cięcia blach o standardowych formatach. Dzięki innowacyjnej i przemyślanej koncepcji przepływu materiału, obrabiane elementy przenoszone są w sposób ciągły i automatyczny ze strefy cięcia. Użytkownik posiada dostęp do tych elementów jeszcze w czasie trwania procesu cięcia. Odbiór elementów jest prosty i wygodny. Strefa odbioru jest łatwo dostępna.



Arkusze blachy układany jest ręcznie na stół i dosuwany do oporu.



Arkusze wciągany jest automatycznie do strefy cięcia. Elementy znajdujące się w obrębie pierwszego segmentu są wycinane.



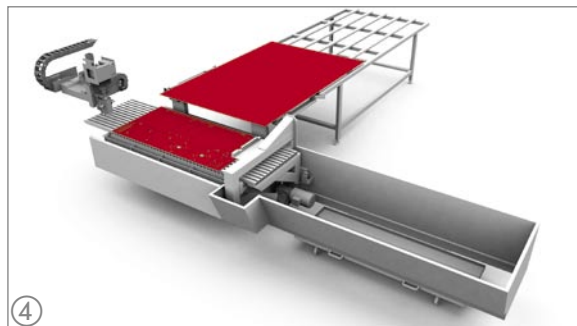
W przypadku ByVention, blacha dzielona jest na segmenty, które są po kolei obrabiane. Istnieją **trzy** różne strategie podziału elementów na arkuszu blachy.

a) Strategia bez nakładania się

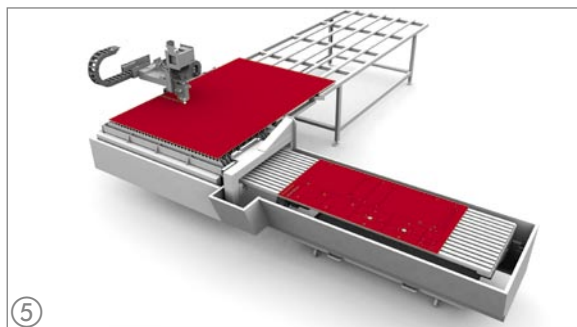
Strategia ta jest odpowiednia dla elementów, które dają się optymalnie rozłożyć na planie prostokąta. Zanim rozpocznie się proces wycinania elementów, segment odcinany jest w linii prostej. Maksymalna długość segmentu odpowiada długości strefy cięcia rzędu 772 milimetrów.

b) Strategia z nakładaniem się i częściowym cięciem

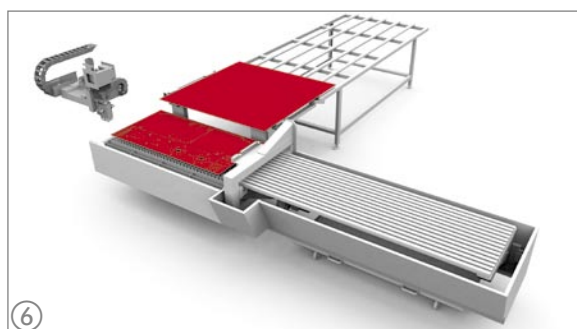
Ta strategia pozwala na maksymalne wykorzystanie blachy w przypadku, gdy elementy nie dają się optymalnie rozmieścić na planie prostokąta. Cięcie nachodzi częściowo na kontury zewnętrzne elementów i tym samym nie zawsze przebiega w linii prostej. Segmenty zazębiają się. Elementy jednego segmentu umieszczone są w obrębie strefy segmentu od 772 do 1562 milimetrów.



Po zakończeniu obróbki, kolejny segment arkusza odkładany jest automatycznie do stołu odbiorczego.



Stół odbiorczy automatycznie przesuwa obrabiany segment arkusza ze strefy cięcia do strefy odbioru. Jednocześnie arkusz blachy wprowadzany jest do strefy cięcia, umożliwiając tym samym cięcie kolejnego segmentu. Wycięte elementy oraz resztki blachy są ręcznie wyjmowane ze strefy odbioru.



Po zakończeniu obróbki, segment arkusza odkładany jest automatycznie do stołu odbiorczego. Proces ten powtarzany jest tyle razy, aż obróbce poddany zostanie cały arkusz blachy. Gdy tylko ostatni segment arkusza znajdzie się w strefie cięcia, wówczas na stole można ułożyć kolejny arkusz blachy.

Oprogramowanie do cięcia i gięcia Bysoft firmy Bystronic obsługuje wszystkie funkcje urządzenia ByVention i w zależności od preferencji, w trakcie programowania przeprowadzany jest automatyczny wybór optymalnej strategii segmentacji arkusza blachy.

c) Strategia z nakładaniem się i całkowitym cięciem

Tą strategię można zastosować alternatywnie do strategii b), szczególnie w przypadku blach o grubości od 3 milimetrów, złożonej geometrii detalu lub gdy wiele części znajduje się w strefie nakładania się. W przeciwieństwie do strategii b) zachodzi tu całkowite cięcie przebiegające w zdefiniowanym odstępnie wzdłuż konturów detalu. Ma to te zalety, że:

1. trzeba tylko raz nakłuć, co przede wszystkim w przypadku grubych blach oszczędza czas i
2. również w przy złożonych detalach i rozmieszczeniach, jak i większych grubościach blachy zagwarantowane jest maksymalne bezpieczeństwo procesów.

Moc lasera	2200 W	4400 W
Nominalny wymiar blachy (długość x szerokość)	3000 x 1500 mm	3000 x 1500 mm
	2500 x 1250 mm	2500 x 1250 mm
	2000 x 1000 mm	2000 x 1000 mm
Strefa cięcia	x = 1562 mm	x = 1562 mm
	y = 772 mm	y = 772 mm
	z = 100 mm	z = 100 mm
Maksymalna prędkość pozycjonowania równoległe do osi x, y	100 m/min	100 m/min
Maksymalna prędkość pozycjonowania jednoczesna	140 m/min	140 m/min
Odchylenie pozycji Pa *	± 0,1 mm	± 0,1 mm
Rozrzut pozycji Ps *	± 0,05 mm	± 0,05 mm
Waga maszyny **	13 500 kg	14 600 kg
Fundament	normalna, uzbrojona podłoga przemysłowa zgodnie z planem ustawienia	
Głowica tnąca 5"	zawarta	zawarta
Głowica tnąca 7,5"	opcjonalnie	zawarta
Zużycie gazu	zależne od materiału	
Obsługa	panel obsługi z ekranem dotykowym	
Napędy nośników danych	złącze USB 1.1 na panelu obsługi	
Przyłącze sieciowe	przyłącze RJ45 10/100 MBit/s	
ByVision (specyfikacje patrz na osobnym arkuszu danych)	opcjonalnie	opcjonalnie

Źródło laserowe CO ₂	ByLaser 2200	ByLaser 4400
Moc	2200 W	4400 W
Długość fali	10,6 μm	10,6 μm
Polaryzacja	kołowa	kołowa
Częstotliwość impulsów	1–2500 Hz	1–2500 Hz
Maksymalne grubości blachy ***		
Stal konstrukcyjna	8 mm	8 mm
Stal nierdzewna	6 mm	8 mm
Aluminium	4 mm	8 mm
Pobór mocy elektrycznej przez urządzenie ****	35 kW	54 kW

* Według VDI/DGQ 3441, odcinek pomiarowy 1 m. Dokładność części z blachy zależna jest od wykorzystanego materiału i od jego obróbki wstępnej oraz wielkości płyty i stopnia jej rozgrzania.

** Kompletne urządzenie do cięcia promieniem lasera bez zespołu chłodząco-filtrującego

*** Aby można było ciąć blachy o maksymalnych grubościach, muszą być spełnione następujące warunki:

- Optymalnie konserwowane i ustawione urządzenie do cięcia
- Materiały muszą mieć cechy jakościowe wymagane przez firmę Bystronic (materiały laserowe)

**** Typowe zużycie wraz z zespołem chłodząco-filtrującym

Zastrzega się możliwość zmian wymiarów, konstrukcji i wyposażenia. Certyfikacja zgodna z ISO 9001

Kontakt z nami

www.bystronic.com